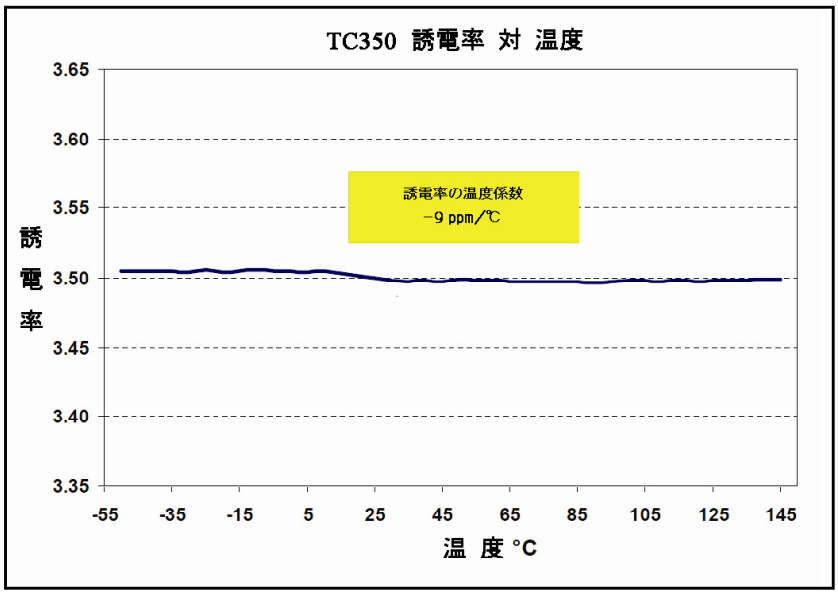
TC350

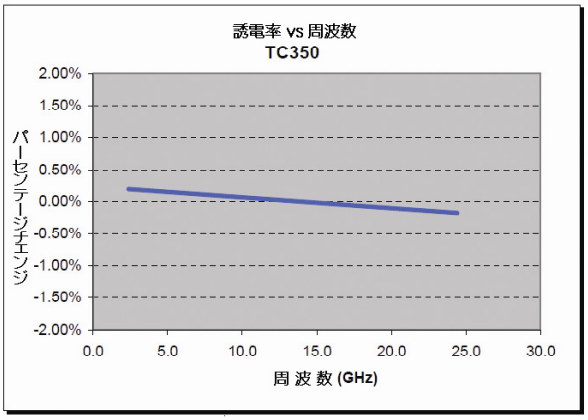
高周波用プリント基板

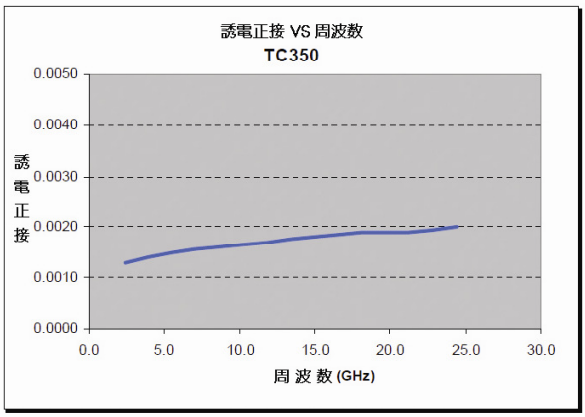
高い放熱性を持つ 誘電率Er=3.5
ガラスクロス・セラミック配合PTFE基板

特長		利点
・優れたの高い熱伝導性	⇒	・放熱性に優れ、システムの熱管理が向上し、その結果、システムの寿命を延ばせる
・低損失	⇒	・優れたアンテナ効率や増幅効率
・大きな基板サイズ	⇒	・コスト面に有利な基板設計および加工が可能



左記の誘電率対温度変化のグラフが示すよう **TC350** は幅広い温度にて安定した特性を保っています。このことにより温度変化(誘電率変化)による特性の変化の発生を最少限におさえます。これは特にパワーアンプやアンテナの設計の助けとなります。





ARLON
MATERIALS FOR ELECTRONICS

日本総代理店 中尾貿易株式会社
〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町12-8
Tel. 03(3662)3201 Fax 03(3661)7118
Email : mw-sales@nakaocorp.co.jp

2009 Rev.H - 09.05版

http://www.nakaocorp.co.jp/microwave/

TC350代表特性

特性	試験方法	条件	代表値
誘電率（@10 GHz）	IPC TM-650 2.5.5.5a	C23/50	3.50
誘電正接（@10 GHz） 誘電正接（@1.8 GHz）	IPC TM-650 2.5.5.5a DM-185-AR	C23/50 C23/50	0.0020 0.0018
誘電率の温度係数（ppm/℃）	IPC TM-650 2.5.5.5 Adapted	-50℃ ～ +140℃	-9
耐アーク性（秒）	ASTM D-495	D48/50	240 以上
比重 （g/cm^3）	ASTM D-792 Method A	A, 23℃	2.30
吸水率 （%）	IPC TM-650 2.6.2.1	E1/105 + D24/23	0.05
熱膨張係数（ppm/℃） X 軸方向 Y 軸方向 Z 軸方向	IPC TM-650 2.4.24 TMA	0℃ ～ 100℃	 7 7 23
熱伝導率（W/mk）	ASTM D5470	50℃, Both 25psi (1.76kg/cm^2) and 432psi (30.37kg/cm^2)	1.0
銅箔引き剥がし強度（kg/cm）	IPC TM-650 2.4.8	温度ストレス後	1.25
NASA ガス放出試験 質量損失(%) 再凝縮物質比(%) 再吸水量比 目視体積凝縮(±)	NASA SP-R-0022A 最大 1.00% 最大 0.10%	125℃,≦10^{-6}torr	 0.02 % 0.01 % 0.01 % NO
難燃性	UL94 Vertical Burn IPC TM-650 2.3.10	C48/23/50,E24/125	UL94V-0 準拠

TC350 主な製品仕様

サイズ　304×457mm、457×609mm、406×914mm 他
工場製造サイズ: 914×1219mmよりカット供給

ｸﾗｯﾃﾞｨﾝｸﾞ　電解銅箔 18μm, 35μm, 70μm厚 両面張り
上記の他異なる厚さの電解銅箔、圧延銅箔
その他金属裏打ち(アルミニウム板、真ちゅう板、銅板)が可能

ここに公表したデータは所定の各試験方法により測定されております。これらは参考目的のために提供されるものであり、製品の仕様または保証値ではありません。物理的なデータの多くは、基板の厚さや樹脂含有率により変化します。製品が持つ様々な特性は、アプリケーション・加工方法・環境などによって変化する事が予想されます。このため、この製品がお客様の各々のアプリケーションに適しているか否かについては、お客様自身の責任で吟味・判断されて下さい。ここに記載している全ては、いかなる法規を犯すものでも、いかなる特許を侵害するものでもありませんし、またその目的も意図もありません。製品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

ARLON
MATERIALS FOR ELECTRONICS